
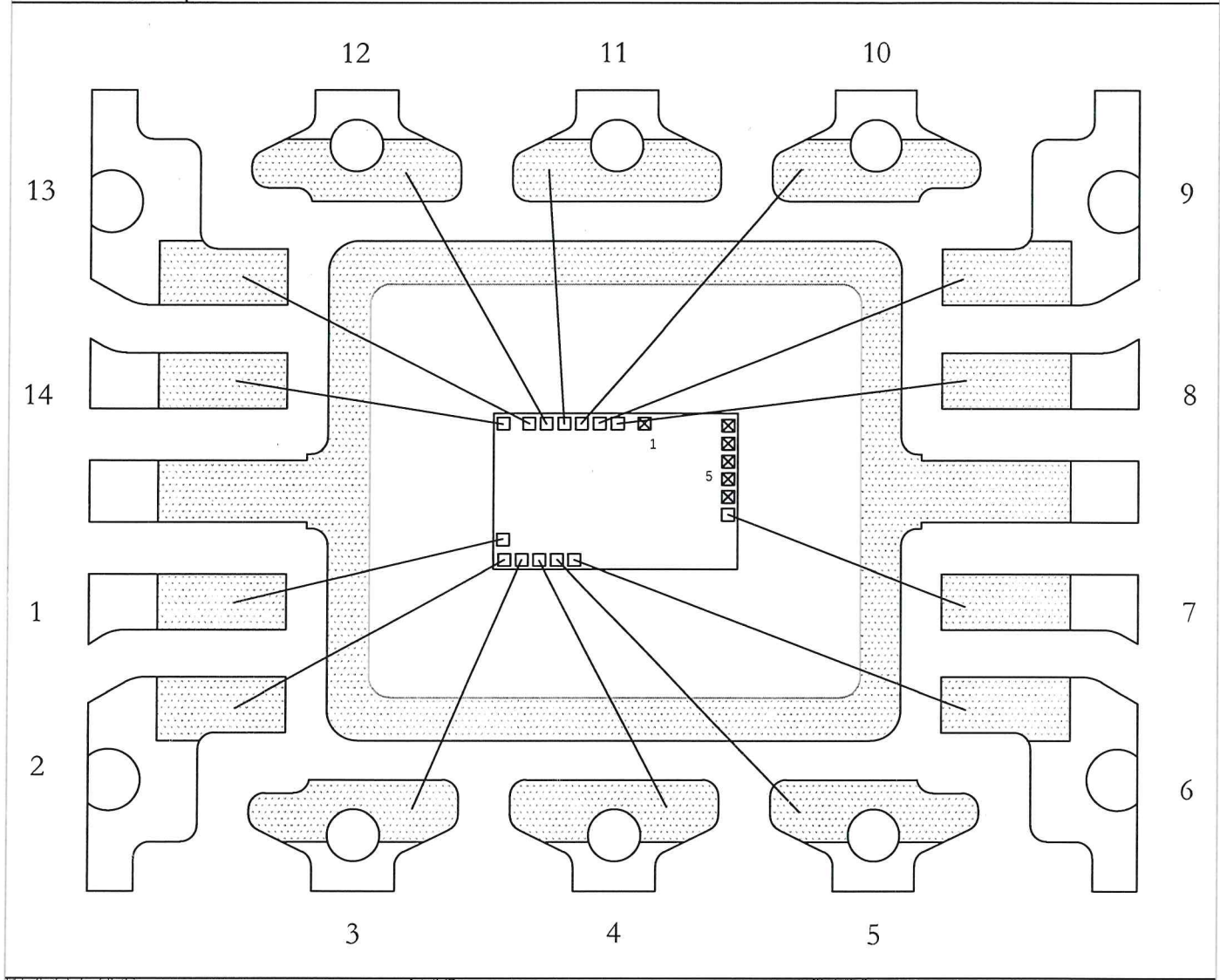
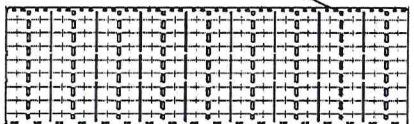


| | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|------------------|--|
| <div> 池州华宇电子科技股份有限公司 CHI ZHOU HISEMI ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD</div> | | | | 客户代码 Customer No. | 008 | 线号 Drawing No. | HY-PX-008-778 A | |
| 焊线图 Bonding Diagram | | | | 产品名称 Product Type | HS26P10 | | 封装外型 PKG Type | SOP14L |
| 焊线种类 Wire Type | 焊线直径(μm) Wire Diameter | 焊线根数 NO. of wire | 焊线总长(μm) Total wire length | 最长线长(μm) Longest wire length | 最短线长(μm) Shortest wire length | 塑封料型号(绿色环保) Compound Type (Green) | | LF载体尺寸 LF Pad Size |
| 合金丝 Ag | 20 | 14 | 24534 | 2048 | 1311 | 首选(Preferred): CEL-1702HF 备选(Optional): EME-G630AY | | SOP14L-8R (95*110mil ²) (2413*2794μm ²) |
| 客户图号 Customer drawing NO. | | | | | | | | |



框架传送方向 (装片):
L/F Direction (D/A):



实物图:
Chip photo:

特殊说明 Special Instructions:

DB注意:
1.芯片居中放置;
WB注意:
1.数字为不打线pad点个数;
HY-PX-008-778 A由HY-PX-008-122 A升级, 优化胶水

| 说明 Instructions | 粘片胶类型 Epoxy type | 芯片名称 Die name | 芯片尺寸 Die Size | 最小焊盘尺寸 Min BPO(μm ²) | 最小焊盘间距 Min BPP(μm) | 铝垫厚度(μm) Pad Thickness | 焊盘下是否有电路 Circuit under Pad | 划片道宽度 Street line (μm) | 晶圆尺寸 Wafer Size | 是否是 Low-K If know? | 减薄厚度 (μm) Wafer Thickness |
|--------------------|-------------------------------|------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------|
| A芯: DIE A | 导电胶 (conductivity) S210 | HS5085 | 1195*755(μm ²) 47.05*29.72(mil ²) | 60*60 | 87 | 1 | 是/Yes | 60 | 8 | 否/NO | 300 |
| B芯: DIE B | | | | | | | | | | | |
| C芯: DIE C | | | | | | | | | | | |
| 拟制 Prepared by | 2024.7.8 | | | 制图日期 Create Date | 2024/7/6 | | 生效日期 Effective Date | 客户确认签字/盖章: Customer Signature | | | |
| 研发审核 R&D Check | 2024.7.8 | | | 产品工程审核 PE Check | | | 批准 Approved by | | | | |